

泰凌微电子（上海）股份有限公司

关于自愿披露公司发布新产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

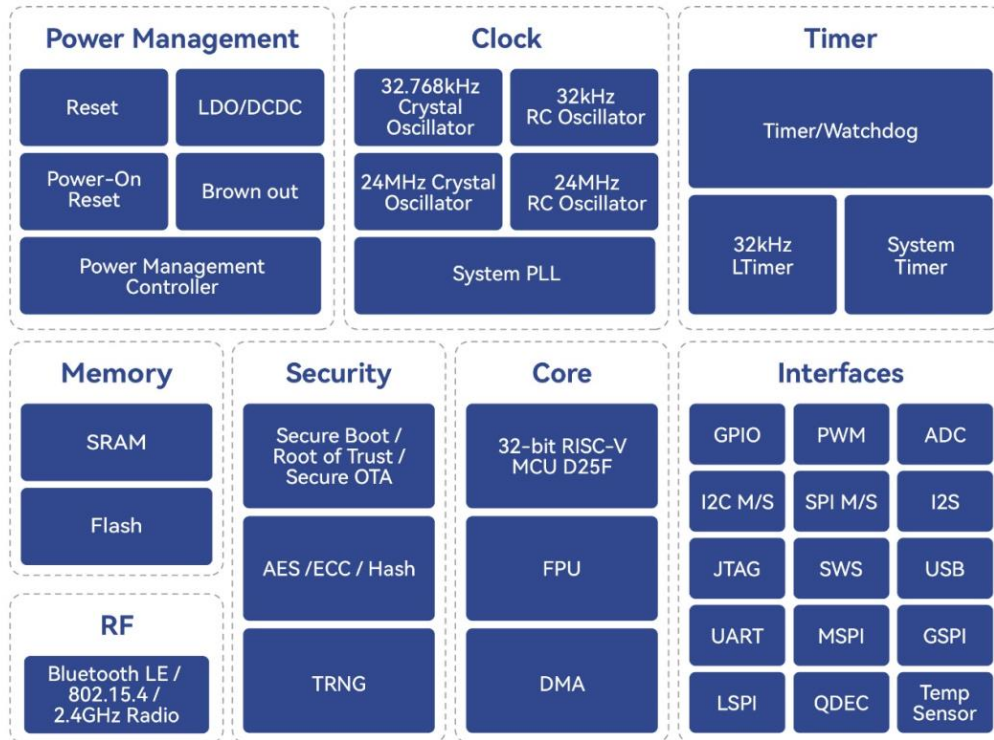
● TLSR925x 系列 SoC 是泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）高性能、低功耗、多协议、高集成度无线连接芯片家族的最新一代产品，是国内首颗实现工作电流低至 1mA 量级的多协议物联网无线 SoC（实测结果）。

● 公司预计 TLSR925x 芯片将于 2024 年内实现批量生产，并在近期开始为先导客户进行开发和提供样品。

● 公司本次发布的新产品未来要实现规模化销售，尚需通过更多客户对该产品进行评估，存在市场推广与客户开拓不及预期的风险。公司尚无法预测新产品对公司当前及未来经营业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

一、新产品基本情况

TLSR925x系列SoC是公司高性能、低功耗、多协议、高集成度无线连接芯片家族的最新一代产品，能够满足未来高性能物联网终端产品对于低碳、融合、安全以及智能等各方面更为严苛的需求。该芯片是国内首颗实现工作电流低至1mA量级的多协议物联网无线SoC（实测结果），在市场同类产品中实现了里程碑的突破。TLSR925x在单个芯片上同时支持蓝牙低功耗和基于IEEE802.15.4的无线通信技术，并支持各类上层协议标准的最新版本。此外，该芯片支持先进的安全特性，帮助终端产品符合全球目标市场日益提升的安全准入要求。



二、新产品对公司的影响

公司TLSR925x后续主要聚焦的是以Matter为代表且支持多协议以及有更高安全要求的各类智能家居设备，同时将开拓血压计、血糖仪、电视、机顶盒遥控器、智能手环、工业传感以及资产物项定位等对功耗要求更高的细分领域市场。公司预计该芯片将于2024年内实现批量生产，并在近期开始为先导客户进行开发和提供样品。

伴随着全球物联网智能硬件的快速发展，物联网无线SoC也在加速迭代升级。为了满足新一代高性能物联网终端产品对于核心芯片的更高要求，公司通过TLSR925x对低功耗的极致追求，不断提升软硬件性能、安全特性和推动ChannelSound-ing等新兴技术普及引领行业潮流，以及助力国产物联网芯片提升全球竞争力。

三、相关风险提示

公司本次发布的新产品未来要实现规模化销售，尚需通过更多客户对该产品进行评估，存在市场推广与客户开拓不及预期的风险。公司尚无法预测新产品对公司当前及未来经营业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会

2024年7月4日